仅供内部参考，请勿外传

通信

证券研究报告
2026 年 06 月 29 日

AI 算力催生高密度互连需求，康宁“玻璃桥”重塑 CPO 先进封装新格局

半导体巨头加速 AI 算力与边缘计算布局

安森美 70 亿美元收购 Synaptics，战略切入“物理 AI”赛道。国际功率半导体龙头以史上最大并购进军边缘 AI，预计 2030 年总潜在市场（TAM）扩大 300 亿美元，标志着 AI 从云端向汽车、机器人等实体终端下沉的产业趋势加速。

高通正式落地数据中心 AI 芯片，向微软、Meta 供货。全球手机芯片龙头发布高带宽计算（HBC）架构及自研 CPU Dragonfly C1000，采用平价普通内存替代高价 HBM，以显著成本优势切入云端 AI 算力市场，直接挑战现有格局。

本周投资观点：

我们认为，在整体宏观环境变化复杂背景下，把握核心高景气行业与资产是重要选择。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

一、人工智能与数字经济：

1、**光模块**&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信**、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技、光库科技、华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、**光纤光缆，推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、**交换机服务器 PCB**：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）**、菲菱科思；**相关标的**：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技、三旺通信、映翰通等。

4、**低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：中国移动、中国电信、中国联通。**

5、**AIDC&散热：**推荐：**英维克（机械联合覆盖）**、**润泽科技**（机械联合覆盖）、润建股份、**光环新网、科华数据**（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、**数据港**（计算机联合覆盖）。相关标的：大位科技、**申菱环境**（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、**AIGC 应用/端侧算力**，推荐：**广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技、翱捷科技（电子组覆盖）。**

二、物联网&智能驾驶：

1、**出海复苏&头部集中，推荐：威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份**（电子联合覆盖）、**亿联网络、广和通、美格智能**等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）**、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技、华测导航**、盛路通信、信科移动、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、**震有科技、通宇通讯**等。

其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯、**海能达、电科网安。

风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险，报告中“相关标的”仅为对相关公司的罗列，不构成任何投资建议。

投资评级

行业评级	强于大市(维持评级)
上次评级	强于大市

作者

王奕红 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517090004
wangyihong@tfzq.com

唐海清 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517030002
tanghaiqing@tfzq.com

康志毅 分析师
SAC 执业证书编号：S1110522120002
kangzhiyi@tfzq.com

余芳沁 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521080006
yufangqin@tfzq.com

袁昊 分析师
SAC 执业证书编号：S1110524050002
yuanhao@tfzq.com

陈汇丰 分析师
SAC 执业证书编号：S1110522070001
chenhuifeng@tfzq.com

张建宇 分析师
SAC 执业证书编号：S1110525040002
zhangjianyu@tfzq.com

曾庆亮 分析师
SAC 执业证书编号：S1110526020004
zengqingliang@tfzq.com

王振铭 联系人
wangzhenming@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《通信-行业研究周报:AI 推动光纤迭代，保偏光纤为 CPO/NPO 关键基石，光纤光缆成长性持续体现》 2026-06-25

2 《通信-行业研究周报:NPO 落地英伟达 Scale-up 方案，光互连市场景气度维持上行》 2026-06-17

3 《通信-行业研究周报:NVIDIA Vera CPU 发布，专为 AI 智能体打造》 2026-06-09

仅供内部参考，请勿外传

重点标的推荐

股票代码	股票名称	收盘价（元）2026-06-29	投资评级	EPS(元) 2025A	2026E	2027E	2028E	P/E 2025A	2026E	2027E	2028E
300308.SZ	中际旭创	1220.00	买入	9.72	24.47	52.75	74.91	125.51	49.86	23.13	16.29
300394.SZ	天孚通信	295.15	增持	2.59	3.92	5.15	7.08	113.96	75.29	57.31	41.69
300502.SZ	新易盛	556.96	买入	9.59	18.58	25.03	31.32	58.08	29.98	22.25	17.78
002463.SZ	沪电股份	141.06	增持	1.99	2.70	3.52		70.88	52.24	40.07	
600522.SH	中天科技	58.84	买入	0.94	1.20	1.47		62.60	49.03	40.03	
600487.SH	亨通光电	108.04	买入	1.09	3.49	4.34	5.03	99.12	30.96	24.89	21.48
688498.SH	源杰科技	1724.83	增持	2.04	4.16	6.67		845.50	414.62	258.60	
000063.SZ	中兴通讯	35.20	增持	1.17	1.19	1.36	1.54	30.09	29.58	25.88	22.86
600941.SH	中国移动	87.60	买入	6.33	5.90	6.20	6.51	13.84	14.85	14.13	13.46
300442.SZ	润泽科技	76.20	买入	3.09	1.87	2.57	3.48	24.66	40.75	29.65	21.90
300638.SZ	广和通	17.95	增持	0.71	0.90	1.12		25.28	19.94	16.03	
002139.SZ	拓邦股份	9.13	买入	0.29	0.41	0.56	0.65	31.48	22.27	16.30	14.05
688100.SH	威胜信息	30.00	买入	1.36	1.75	2.13	2.56	22.06	17.14	14.08	11.72
300628.SZ	亿联网络	33.55	买入	2.09	2.46	2.83		16.05	13.64	11.86	
002837.SZ	英维克	76.70	增持	0.61	1.05	1.46		125.74	73.05	52.53	

资料来源：Wind，天风证券研究所

仅供内部参考，请勿外传

1. 康宁玻璃基板：光电合封的技术原理

6 月 24 日，康宁在韩国首尔举行的“人工智能（AI）数据中心光通信与互连技术大会”上发布了**下一代光互连组件——玻璃桥（Glass Bridge）**。

玻璃桥是一款玻璃光连接器，可**直接对接光子集成电路（PIC）与光纤**。片上光波导宽度仅数百纳米，而光纤纤芯宽度为数微米，二者尺寸相差数十倍；玻璃桥依托玻璃内部制备的光波导，精准完成两类器件的光路对接。

康宁公司应用**晶圆级离子交换波导技术**在玻璃内部形成光波导，光纤传输的光信号通过玻璃波导传输至光芯片，并在光子集成电路前端实现高密度光 I/O 连接。该技术简化了光纤与光芯片之间的对准和组装，并省去了传统的插拔式收发器或长光纤阵列器件（FAU）。

康宁正在开发的初期产品，将支持 30 微米或更大的光半导体纤芯间距，目标是将光纤与光学半导体之间的耦合损耗（Coupling Loss）控制在 2 分贝（dB）以下。

康宁目前正与多家合作伙伴共同开发玻璃桥技术。去年，该公司宣布与**格芯（GlobalFoundries）**就人工智能数据中心的光互连技术展开技术合作。

康宁公司还发布了**新一代 CPO 结构**。该结构**将玻璃基板和光互连相结合**，在采用玻璃通孔电极（TGV：Through Glass Via）的玻璃基板上形成光波导，并通过倒装芯片（Flip Chip）方式连接安装光芯片。这项技术旨在满足未来基于玻璃基板的半导体封装市场不断增长的需求。

除此之外，康宁还发布了 **GlassWorks AI 平台**，一套面向 AI 数据中心的光通信整体解决方案。GlassWorks AI 可为数据中心机柜内部、机柜之间、跨园区数据中心提供一体化光互连基础设施，平台涵盖光纤、光缆、连接器、光纤阵列单元及各类对准器件。

近期，康宁加大了美国北卡罗来纳州、得克萨斯州以及波兰的光通信产线投资力度，并与 **Meta、英伟达、亚马逊等**超大规模云厂商签订了**数十亿美元长期供货协议**。“光纤需求持续攀升，同时行业对互连密度、传输性能的要求不断提高。”康宁光通信副总裁 Ko Joo-hyun 表示，“GlassWorksAI 平台整合光纤、光缆、连接器、光耦合等全套技术，能够充分匹配下一代数据中心的建设需求。”

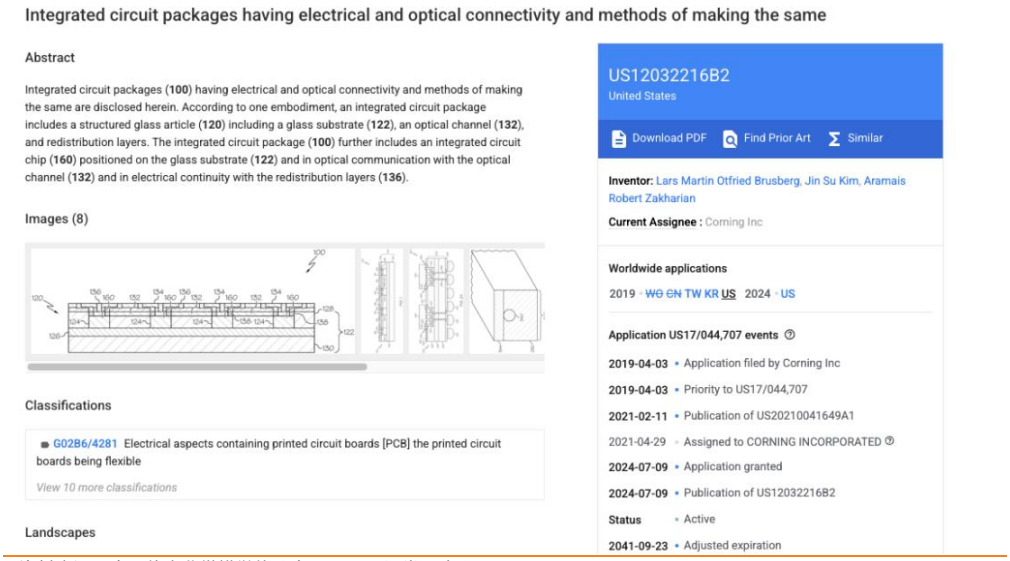
在国内，康宁与**京东方**签署了合作备忘录，京东方在显示器件、显示模组、先进制造、工艺开发、应用创新及产业化落地等方面具备领先能力，康宁公司在玻璃材料、半导体应用先进材料与解决方案等方面具有显著优势，双方基于上述情况将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。

其中，在**玻璃基封装载板业务**，京东方于 2024 年投资了 **9.93 亿元**建设**玻璃基封装载板试验线**。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。不过截至目前，京东方还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收，试验线良率尚未达到量产水平。

而在**光互连业务**，京东方也有所布局，下属子公司于 2023 年投资建设 **MicroLED 芯片生产线**，目前其 MicroLED 光互联芯片已产出相关样品并为客户送样。

图 1：外部激光源（ELS）通过保偏光纤连接光引擎示意图

仅供内部参考，请勿外传



资料来源：半导体产业纵横微信公众号，天风证券研究所

一、技术背景

高性能计算和数据中心应用需要高数据传输速率。传统的光互连方案虽然能够提供高数据传输速率，但可能会因增加元件而产生不必要的成本、消耗大量电力，并且制造难度较高。因此，市场可能更需要集成了电连接和光连接的集成电路封装。

二、概述

康宁公开了**具有电气和光学连接的集成电路封装及其制造方法**。

集成电路封装包括：**结构化玻璃制品**，该结构化玻璃制品包含**玻璃基板、光通道和重分布层**；以及位于玻璃基板上的**集成电路芯片**，该芯片与光通道进行光通信，并与重分布层保持电连续性。

三、详细描述

一般来说，集成硅基光子器件的集成电路与互补金属氧化物半导体（CMOS）技术兼容，可用于高速芯片间光通信。此类包含分立光子通信通道的传统集成电路通常包含各种独立组装和连接的组件，例如激光器、调制器、光纤、接收器等。在单板规模下，传统的基于光纤的板载互连可能是一种经济高效的解决方案。然而，随着连接数量的增加，这些组件的扩展性会受到影响。

与包含分立光子通信通道的集成电路相比，本发明公开的集成光子集成电路封装具有**制造良率高、尺寸小、功耗低**等优势。此类集成电路封装可包括嵌入玻璃基板的光波导光通道。这种光通道可实现大规模通信，并有助于提高封装的紧凑性。特别是，安装在具有光波导的玻璃基板上的集成电路芯片之间的光互连，可在短距离内提供高密度、高比特率的通信链路，这对于高性能计算和数据中心应用尤为有利。此类集成电路封装配置的性能可能**超越传统的铜基集成电路封装**。

作为背景知识，集成电路封装是半导体器件制造的后端工艺，其中半导体材料块被封装在一个支撑外壳中，该外壳提供芯片密度到印刷电路板密度的电气连接。这个外壳，也称为"封装体"，支撑着将器件连接到电路板的电触点。该工艺通常被称为封装，但也可能被称为半导体器件组装、封装或密封。

与传统的集成电路封装相比，如本申请公开的集成在玻璃基板上的集成电路封装，**其尺寸稳定性可能优于传统的有机封装**。此外，玻璃基板的热膨胀系数可能与集成电路本身的材料更加匹配。因此，在各种温度下运行集成电路或在高温下制造集成电路及其封装，有助于减少相邻元件的应力。传统的有机封装通常与集成电路本身的材料的热膨胀系数存在较大差异。

仅供内部参考，请勿外传

晶圆级封装是一种**将集成电路在晶圆状态下进行封装**的技术，这与将晶圆切割成单个电路后再进行封装的传统方法截然不同。晶圆级封装可以实现晶圆制造、封装、测试和老化的晶圆级集成，从而简化器件从硅片设计到客户交付的整个制造流程。晶圆级封装还可以扩展晶圆制造工艺，使其包含器件互连和器件保护工艺。

一种晶圆级封装是**扇入式**，其所有触点端子都位于芯片的封装范围内。这种配置在调整触点布局以匹配下一层基板设计时会存在局限性。**扇出式**是另一种晶圆级封装，代表了芯片级封装和扇入式晶圆级封装之间的折中方案。扇出式晶圆级封装涉及将半导体晶圆切割，然后将单个集成电路嵌入到重构或人工模塑的晶圆中。重构晶圆上的芯片彼此之间保持足够大的距离，以便使用标准晶圆级封装工艺制造所需的扇出式重分布层。扇出式晶圆级封装提供了一种将引脚间距较小的芯片连接到引脚间距较大的印刷电路板的方法。

集成电路封装包括**结构化玻璃制品**和安装在结构化玻璃制品上的**集成电路芯片**。结构化玻璃制品包括**玻璃基板**，该玻璃基板具有空腔，集成电路芯片位于空腔内。玻璃基板包括**玻璃芯层**，该玻璃芯层耦合到上层玻璃包覆层和下层玻璃包覆层。玻璃基板包含多层玻璃，可视为玻璃层压板。

玻璃基板可以具有任何合适的成分，并可采用任何合适的方法制成。合适的玻璃成分示例包括碱土铝硼硅酸盐玻璃、锌硼硅酸盐玻璃和钠钙玻璃，以及玻璃陶瓷，例如富含氧化镁、氧化钇、氧化铍、氧化铝或氧化锆的玻璃陶瓷。

玻璃基板的另一个可广泛变化的方面是**各层的玻璃成分**。例如，各层可以具有相同的玻璃成分，也可以具有不同的玻璃成分；或者其中两层具有相同的玻璃成分，而第三层具有不同的玻璃成分。通常，一个或两个玻璃包覆层的玻璃成分与玻璃芯层的玻璃成分不同。这使得玻璃包覆层具有某些特性，使其适用于形成空腔。

结构化玻璃制品还包括**光接口**，该光接口将集成电路芯片的**集成光发射器和/或接收器**（本文中称为“光端口”）与结构化玻璃制品的光通道进行光通信。通过将集成电路芯片的光端口与结构化玻璃制品的光通道进行光通信，集成电路封装允许将集成电路芯片同时组装到结构化玻璃制品上，同时**保持电信号与光通信信号的分离**。

光通道可包括嵌入其内的**集成玻璃波导**。玻璃波导可采用**激光波导写入工艺**在光通道中形成，其中激光将脉冲紧密聚焦在光通道的主体内部，激光脉冲在激光焦点周围的小体积区域内局部沉积能量，从而引起光通道内部折射率的局部改变。

或者，玻璃波导可以通过**离子交换工艺**形成。在离子交换工艺中，对光通道的特定表面进行掩膜，并将掩膜后的光通道浸入含有盐的溶液中。盐浴的材料取决于光通道的组成。例如，使用特定的玻璃组合物，盐浴中包含银离子。

盐浴中的离子会取代玻璃中的离子，导致光通道的暴露部分发生位移。根据盐浴离子和玻璃离子的相对大小，取代离子可能使光通道的暴露表面保持压缩或拉伸状态。光通道内部应力场的改变形成了玻璃波导。光通道浸没的时间以及盐浴的浓度等因素会影响引入光通道的应力场的深度和强度。玻璃波导中改变的应力场导致其内部玻璃的折射率与光通道的其余部分不同。

玻璃波导与剩余光通道之间的折射率差异使得光通道可以用作光波导。光通道与玻璃波导以及周围环境的折射率差异限制了从光通道沿垂直于入射方向的方向逸出的光量。

结构化玻璃制品还包括多个**光接口**，这些光接口将集成电路芯片的集成光端口与结构化玻璃制品的光通道（特别是玻璃波导）进行光通信。

结构化玻璃制品还包括多个**电凸点**，用于在集成电路芯片和结构化玻璃制品之间提供连接和电连续性。结构化玻璃制品还包括**重分布层**，用于在整个结构化玻璃制品中提供电连续性。

固化的电凸点还提供了相邻组件的机械连接，并保持集成电路芯片相对于玻璃基板的位置。保持集成电路芯片相对于玻璃基板的位置对于保持与集成电路芯片和结构化玻璃制

仅供内部参考，请勿外传

品的光通道耦合的光接口的对准至关重要。光接口的精确对准可确保与集成电路芯片之间光通信信号的稳定传输。通常情况下，光接口的未对准是难以容忍的。

2. 近期重点行业动态以及观点（6.22-6.26）

2.1. AI 行业动态

安森美史上最大并购落地（微信公众号：第一财经）

当地时间 6 月 25 日，国际功率半导体龙头安森美（onsemi）发布公告称，计划以约 70 亿美元的全股票交易收购边缘计算芯片厂商 Synaptics，这是安森美成立以来规模最大的一笔并购交易。该交易预计于 2027 年中期完成，须获得 Synaptics 股东批准、所需监管批准及其他惯例成交条件。

此次收购被视为安森美战略转型的重要一步。一年前，安森美曾因“没有可行路径”而放弃以 69 亿美元收购 Allegro MicroSystems，而这次选择 Synaptics，安森美意在进军当下火热的“物理 AI”赛道，即 AI 从云端下沉到汽车、机器人、工业设备等实体终端的能力。通过此次收购，安森美预计其总潜在市场（TAM）有望在 2030 年扩大 300 亿美元，达到 2430 亿美元。

Synaptics 是一家老牌触控芯片厂商，2004 年，苹果 iPod 搭载的点击轮（Click Wheel）采用了 Synaptics 的电容触控技术；2007 年，Synaptics 为三星 B310 手机提供了触控传感器，奠定了其在触控交互领域的领导地位；2020 年前后，公司开始全面转向物联网与边缘 AI 领域，其客户覆盖 PC、智能手机、汽车（如宝马、大众、比亚迪）及机器人等多个领域。

高通：将向微软和 Meta 供货最新 AI 芯片（微信公众号：第一财经）

高通周三披露，微软、Meta 将采用其全新 AI 芯片方案；同时公司还将为另外两家未具名超大型云厂商开发定制化芯片。这家全球智能手机芯片龙头企业举办投资者沟通会，正式落地数据中心 AI 芯片布局。

高通介绍，微软将采用其全新高带宽计算（HBC）芯片架构。该方案依托手机、笔记本通用的平价普通内存，而非英伟达高价 HBM 高带宽内存、Cerebras 所用静态存储 SRAM，成本优势突出。Meta 则将搭载高通专为 AI 数据中心设计的自研 CPU——Dragonfly C1000。

铜关税，重要时点临近！AI 算力金属再迎变局（微信公众号：券商中国）

随着 6 月 30 日临近，全球 AI 算力金属再迎变局。届时，美国 232 关税调查将出炉。对铜的新关税预期已经给全球市场带来了冲击，一旦成行，高盛等金融机构预计，美国买家将掀起新一轮囤货潮。目前美国 COMEX 库存已攀升至 65 万吨上方的历史高位。同时，锡、钽、铟与 AI 算力产业绑定程度较深的品种，涨价线索也有望进一步丰富。

根据伦敦金属交易所（LME）公布的数据，上周伦铜库存整体继续去化，最新库存水平为 35.21 万吨，降至近三个月新低。而上周，COMEX 铜库存继续增加，最新库存水平为 65.22 万吨，再创历史新高。业内人士认为，如果美国关税如期实施，美国铜价可能进一步飙升，非美地区的铜则可能因为供应外流而陷入更深的短缺。

OpenAI 最强 GPT-5.6 发布！（微信公众号：新智元）

OpenAI 首次启用太阳、大地、月亮命名，全新 GPT-5.6 正式登场。旗舰 Sol 编程屠榜，只当了 17 天第一的 Claude Mythos 5，被一夜拉下王座。

OpenAI 这次重点秀的能力有三个：编程、生物、网络安全。编程方面，他们刷的是目前最能衡量 AI 编程能力的基准之一——Terminal-Bench 2.1。它考的是代码规划、工具调用、多轮迭代纠错这样完整的命令行工作流，是一个模型能不能像真正的工程师那样端到端地完成复杂项目。结果显示，Sol 在 ultra 模式下跑出了 91.9%，拿下了所有已公开模型的

仅供内部参考，请勿外传

最高分。作为对比，Anthropic 两周前刚发布的 Claude Mythos 5 在同一基准上是 88.0%，Fable 5 是 84.3%。Sol 关掉 ultra 只用 max 模式也有 88.8%，单凭这一个数字就已经超过了 Anthropic 两个最新旗舰。网络安全，则是 OpenAI 在博客里着墨最多的方向。GPT-5.6 Sol 在 ExploitBench 上的表现，几乎打平了 Anthropic 之前强到不敢发的 Mythos Preview，但只消耗了约三分之一的输出 token。

OpenAI 曝出第一颗芯片叫「辣椒」！AI 自己设计，9 个月流片（微信公众号：新智元）

OpenAI 首颗自研芯片 Jalapeño 问世，9 个月白纸到流片，创下行业最快纪录。设计它的，正是跑在上面的 AI 模型。

官方定位叫「Intelligence Processor」，一颗专为大模型推理设计的定制 ASIC。由 OpenAI 主导架构设计，Broadcom 负责芯片实现和网络互联，Celestica 做板卡和机架集成。

CVPR 2026 最热方向，被一家杭州团队率先跑进了端侧！（微信公众号：量子位）

Om AI 发布全球首个面向物理世界的端侧流式多模态模型系列——VLX。

VLX 主打真实世界的端侧与具身场景，总共三款模型，三天连发：VLX-Flow：实时流式感知，让视频像水流一样持续输入，模型实时看、实时想、实时更新世界状态。VLX-Seek：精准定位，从看见走向看清，快速锁定目标。VLX-Go：行动决策，把感知和定位的结果转化成真实动作——该往哪走、怎么操作，一气呵成。这三款模型连起来，不仅构成了多模态模型持续感知、精准定位、行动决策的能力闭环。

2.2. 光通信行业动态

链博会首日 中天科技重磅发布 17280 芯超大芯数高密度光缆（微信公众号：光纤在线）

6/23/2026，光纤在线讯，6 月 22 日，在第四届中国国际供应链促进博览会上，中天科技现场重磅发布 17280 芯超大芯数高密度光缆，刷新行业芯数纪录，为算力网络打造新一代高密传输底座。

相较传统 288 芯光缆，传输容量提升 60 倍；同等容量下，管道占用空间减少 92%，同时综合碳排放降低 88%，契合“双碳”发展要求。产品支持多级分支、多模式端接，适配超大规模数据中心、AI 智算集群与骨干传输网，兼顾扩容便捷性与全生命周期降本增效。

Singtel 出售泰国资产加码 AI 与数据中心业务（微信公众号：光纤在线）

6/24/2026，光纤在线讯，Lightreading 报道，新加坡电信 Singtel 日前宣布出售泰国 Gulf Development 2.8% 股权，所得约 7.72 亿美元资金将用于扩张数据中心与人工智能业务。

本次股权以私募配售方式面向机构投资者完成出让，累计实现股权账面收益约 1.4 亿新加坡元（折合 1.081 亿美元）。交易完成后，Singtel 集团仍持有 Gulf Development 4.95% 股权，对应资产估值约 18 亿新加坡元（折合 13.9 亿美元）。

Singtel 集团首席财务官 Arthur Lang 在周二发布的声明中称：“本次资产剥离体现 Singtel 持续优化资产组合，秉持审慎资本管理策略。Gulf Development 上市以来股价表现亮眼，为我们兑现资产价值提供优质窗口，回笼资金可重新投向增长赛道，同时提升股东回报。”

华辰芯光发布 Nova 产品-1000mW 单模 980nm 泵浦激光芯片，专为光纤通信、数据通信、卫星通信用光放大器(Optical Amplifier）设计（微信公众号：光纤在线）

6/22/2026，光纤在线讯，近日，华辰芯光（WinCO）宣布推出其最新款 Nova 芯片产品-超高功率 SHP（Super High Power）单模 980nm 泵浦激光芯片。

芯片能在-45° C~85° C 应用环境下稳定输出超过 1000mW 出光功率，同时实现阈值电流低于 70mA 的优异指标。Nova 产品将高功率、高精度与低噪声特性集成于紧凑型 CoC 封装中，旨在满足数据通信、卫星通信、陆地及海洋光纤通信等对高可靠泵浦激光光源的严苛需求。该芯片的成功发布，打破了海外巨头在光放大器领域对大功率单模 980nm 泵浦激光芯片的长期垄断局面，华辰芯光也成为全球能批量生产该类高端泵浦激光芯片

仅供内部参考，请勿外传

的极少数企业。

2.3. 商业航天行业动态

长七改火箭成功发射通信技术试验卫星二十六号 A 星（微信公众号：中国航天科技集团）

6 月 23 日 10 时 10 分，长征七号改运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞，随后将通信技术试验卫星二十六号 A 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

通信技术试验卫星二十六号 A 星由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展相关技术试验验证。

长七改火箭由航天科技集团一院抓总研制，是我国新一代中型高轨液体运载火箭。该型火箭可适配直径 4.2 米和 3.7 米两种整流罩，具备一箭一星和一箭双星发射能力。

3. 本周行业投资观点

本周投资观点：

冲突局势动荡，影响市场风偏和流动性，对 AI 科技产业也产生了预期的扰动。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

中长期我们持续推荐 AI 算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI 和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT 设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT 应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）商业航天&“天地一体化”为 6G 重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。

人工智能&数字经济是未来产业长期大趋势：算力+网络+存储+散热为主要受益方向，AI 新科技浪潮将持续拉动 ICT 设备商、光通信、PCB、散热温控等需求，长期重视其相关投资机会；

以满足流量增长为目标的有线网络扩容：随着 5G 用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫；

以满足应用和内容增长需求的云计算基础设施和物联网硬件终端投资：ISP 厂商基于新应用和新内容增长，加大云计算基础设施投入，包括 IDC、网络路由交换、服务器、配套温控电源、光模块及光器件的新一轮景气提升。

双碳长期目标下，重点关注通信+新能源，另外应用端，云视频、数据、物联网/智能汽车、工业互联网、商业航天等行业应用进入加速发展阶段，中长期成长逻辑清晰，进入重点关注阶段。

具体细分行业来看：

一、 人工智能与数字经济：

仅供内部参考，请勿外传

1、光模块&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信**、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技、光库科技、华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、**光纤光缆，推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、交换机服务器 PCB：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）**、菲菱科思；**相关标的**：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技、三旺通信、映翰通等。

4、**低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：中国移动、中国电信、中国联通。**

5、AIDC&散热：推荐：**英维克（机械联合覆盖）**、**润泽科技**（机械联合覆盖）、润建股份、**光环新网、科华数据**（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、**数据港**（计算机联合覆盖）。相关标的：大位科技、**申菱环境**（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、AIGC 应用/端侧算力，推荐：**广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技、翱捷科技（电子组覆盖）。**

二、物联网&智能驾驶：

1、出海复苏&头部集中，推荐：威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）、**亿联网络、广和通、美格智能**等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）**、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技、华测导航**、盛路通信、信科移动、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、**震有科技、通宇通讯**等。

其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯、**海能达、电科网安。

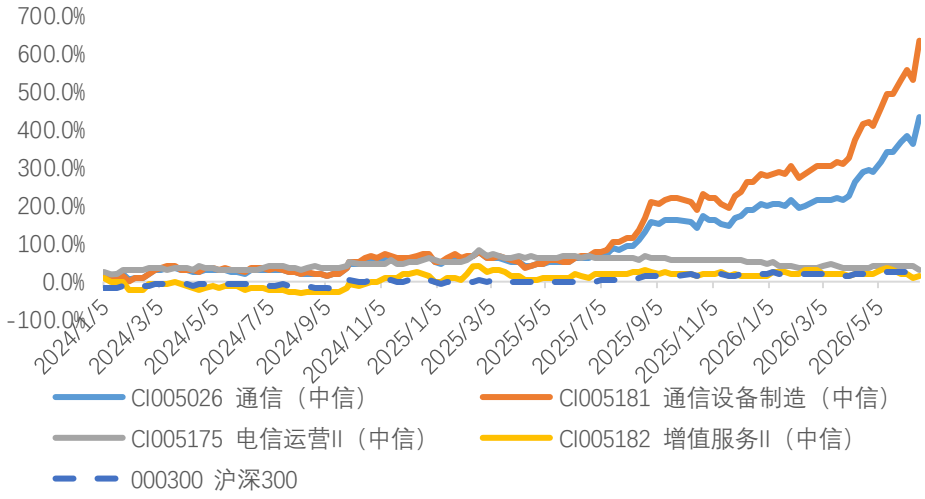
4. 板块表现回顾

4.1. 本周（06.22-06.26）通信板块走势

本周（06.22-06.26）通信板块下跌 4.26%，**跑输沪深 300 指数 2.78 个百分点，跑输创业板指数 2.90 个百分点。其中通信设备制造**下跌 4.09%，**增值服务**下跌 8.75%，**电信运营下跌 5.40%**，同期沪深 300 下跌 1.48%，创业板指数下跌 1.37%。

图 1：本周（06.22-06.26）板块涨跌幅

仅供内部参考，请勿外传



资料来源：Wind，天风证券研究所

4.2. 本周市场个股表现

本周通信板块涨幅靠前的个股有瑞玛精密、长飞光纤、剑桥科技；跌幅靠前的个股有会畅科技、铭普光磁、美格智能。

表 1：本周（06.15-06.19）通信板块个股涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
证券代码	证券简称	周涨幅（%）	证券代码	证券简称	周涨幅（%）
002976	瑞玛精密	26.75%	002194	武汉凡谷	-16.08%
601869	长飞光纤	15.15%	000889	中嘉博创	-16.17%
603083	剑桥科技	14.63%	688205	德科立	-16.59%
002491	通鼎互联	14.47%	600293	三峡新材	-16.99%
002837	英维克	11.03%	002906	华阳集团	-17.37%
002335	科华数据	10.77%	603920	世运电路	-17.61%
300762	上海瀚讯	10.64%	688270	ST 臻镭	-17.79%
688387	信科移动-U	10.10%	002881	美格智能	-18.38%
603738	泰晶科技	9.08%	002902	铭普光磁	-18.55%
603700	宁水集团	9.05%	300578	会畅科技	-20.91%

资料来源：Wind，天风证券研究所

5. 下周（06.29-07.03）上市公司重点公告提醒

表 2：下周（06.29-07.03）通信板块上市公司重点公告提醒

星期	日期	公司	事件
周一	6 月 29 日	特发信息、日海智能、星网锐捷、瑞玛精密、航宇微、金信诺、佳禾智能、特发信息	股东大会召开
		亨通光电、共进股份、云里物里	分红派息
		亨通光电、共进股份、云里物里	分红除权
周二	6 月 30 日	梦网科技、合众思壮、ST 恒信、锐捷网络、ST 信通、*ST 实达、长飞光纤	股东大会召开
		紫光国微、霍莱沃、中国铁塔	分红派息
		紫光国微、霍莱沃	分红除权
周三	7 月 1 日	云里物里	股东大会召开
		三旺通信	分红除权
		三旺通信	分红派息
		兆龙互联、翱捷科技-U	限售股份上市流通

仅供内部参考，请勿外传

周四	7 月 2 日	奥飞数据 奥飞数据	分红除权 分红除权
周五	7 月 3 日	中嘉博创、盛洋科技	股东大会召开

资料来源：Wind，天风证券研究所

6. 重要股东增减持

表 3：本周公告通信股重要股东增减持

名称	变动截止日期	股东类型	方向	变动数量(万股)	占总股本比例(%)	交易平均价（元）	6 月 26 日收盘价（元）	周内股价变动
菲利华	2026-06-22	高管	减持	2.0000	0.004%	139.30	139.96	3.10%
华测导航	2026-06-18	高管	增持	12.0000	0.015%	29.37	27.78	-5.12%
华测导航	2026-06-22	高管	增持	19.0000	0.024%	28.57	27.78	-5.12%
华测导航	2026-06-23	高管	增持	4.0000	0.005%	27.95	27.78	-5.12%
瑞玛精密	2026-06-18	公司	减持	149.0800	0.766%		27.66	26.75%

资料来源：Wind，天风证券研究所

7. 限售解禁

未来三个月限售解禁通信股共 8 家，解禁股份数量占总股本比例超过 15%的公司有中贝通信、中瓷电子。

表 4：未来三个月通信股限售解禁

公司名称	解禁日期	解禁数量(万股)	占总股本比	6 月 26 日收盘价（元）	解禁股市价（万元）	解禁股份类型
兆龙互连	2026-07-01	3,007.05	8.77%	50.75	152,607.57	定向增发机构配售股份
翱捷科技-U	2026-07-01	4,916.16	11.75%	99.84	490,828.99	首发原股东限售股份
生益科技	2026-07-06	1,730.88	0.71%	178.50	308,962.85	股权激励限售股份
长芯博创	2026-07-17	2,200.00	7.47%	262.65	577,830.00	定向增发机构配售股份
深桑达 A	2026-07-30	7,722.01	6.35%	24.22	187,027.03	定向增发机构配售股份
中贝通信	2026-08-05	10,208.58	19.03%	21.65	221,015.86	定向增发机构配售股份
中瓷电子	2026-09-11	11,089.62	24.59%	183.10	2,030,508.74	定向增发机构配售股份
盛科通信-U	2026-09-14	604.69	1.47%	327.50	198,035.42	首发战略配售股份

资料来源：Wind，天风证券研究所

仅供内部参考，请勿外传

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com